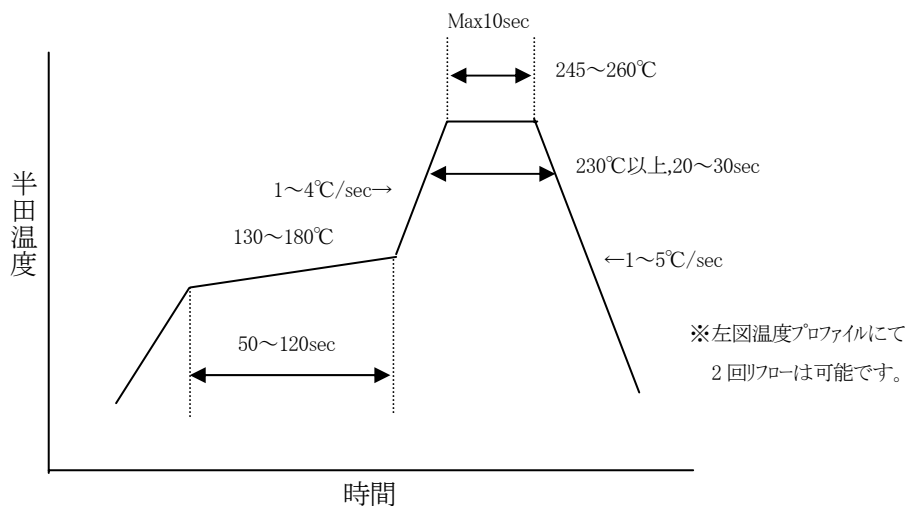


鉛フリー対応品 半田実装条件

【半田リフロー条件】

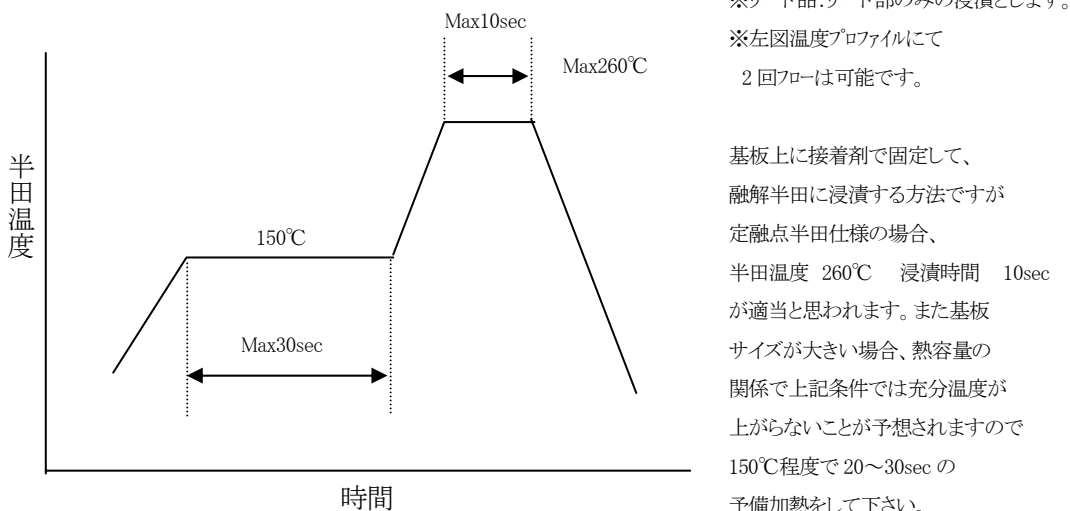
SC-59,SC-74,SC-70,SC-75A,USM6F,T-USM,SC-88,SC-88A,SOT-89 パッケージ
(TO-92S パッケージ製品においての、リフロー実施は対象外となっています。)



赤外線リフロー時の樹脂表面部の温度プロファイル (リフロー後、基板の強制冷却は避けてください。) 半田濡れ性を確保するため、ピーク温度 245°C 以上であることを推奨致します。

【半田フロー条件】

SC-59,SC-74,SC-70,SC-75A,SC-88,SC-88A,SOT-89,TO-92S パッケージ
(USM6F,T-USM パッケージ製品においての、フロー実施は対象外となっています。)



半田濡れ性を確保するため、ピーク温度 245°C 以上であることを推奨致します。

【手半田付け条件】

半田温度 380°C 以下、3 秒以内で温度・時間に充分注意してご使用下さい。